¢

DERWENT-ACC-NO: 1983-779875

DERWENT-WEEK: 198340

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Embossed release sheet comprising embossed paper -

and ionising

radiation cured film, has excellent heat resistance

PATENT-ASSIGNEE: DAINIPPON PRINTING CO LTD[NIPQ]

PRIORITY-DATA: 1982JP-0025548 (February 19, 1982)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO PUB-DATE LANGUAGE

PAGES MAIN-IPC

JP 58144187 A August 27, 1983 N/A

004 N/A

JP 89010626 B February 22, 1989 N/A

000 N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

JP 58144187A N/A 1982JP-0025548

February 19, 1982

INT-CL (IPC): B05D005/00; B32B027/00; B32D027/10;

D06N003/00 ;

D06N007/00; D21H001/34; D21H005/02

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 58144187A

BASIC-ABSTRACT: Embossed releasing sheet comprises (A) an embossed paper and

(B) ionising radiation-curing film formed on one side of

(A). In the pref.

prepn., a coating which contains (a) a cpd., contg.

ethylenic-unsatd. bonds,

as main component is applied on one side of paper to form uncured coat layer.

The coat layer is embossed. The coat layer is irradiated with electron rays or

UV rays to form an ionising radiation-cured film.

The sheet has proper releasing properties, excellent thermoresistance, weather

resistance, chemical resistance and abrasion resistance, etc. Since curing is carried out with electron rays or UV rays, the embossment does not sag with heat.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/2

TITLE-TERMS:

EMBOSS RELEASE SHEET COMPRISE EMBOSS PAPER IONISE RADIATE CURE FILM HEAT

RESISTANCE

DERWENT-CLASS: A32 A94 P42 P73

CPI-CODES: A11-C02B; A11-C04C; A12-B03;

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0212 0229 2009 2016 2194 2198 2393 2427 2436

2479 2493 2496 2600

2604 2605 2607 2657 2725

Multipunch Codes: 013 03- 231 246 331 353 359 398 402 414

431 442 466 468 473

477 541 542 543 545 597 598

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1983-095768 Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1983-175804



## (9) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭58—144187

6) Int. Cl.³ D 06 N 7/00	識別記号	庁内監理番号 71804 F	❸公開 昭和58年(1983)8月27日
B 32 B 27/00 27/10 D 21 H 1/34		6921—4 F 6921—4 F 7921—4 L	発明の数 2 審査育求 未請求
5/02		7921—4 L	(全 4 頁)

**匈エンボス付き離型紙及びその製造方法** 

千葉市小中台町1396-11-305

顧 昭57-25548

切出 願 人 大日本印刷株式会社

12番地

②出 顯 昭57(1982)2月19日

東京都新宿区市谷加賀町1丁目

⑫発 明 者 土屋博隆

個代 理 人 弁理士 小西淳美

9 0 0

199030

②)特

エンポス付合口はほびその口む方位

2 6 6 0 2 0 0 0

(1) 日の片面に日口放出口口化口がほけられ、風 つ日口放出口口化口がほけられた口にエンカ エが口こをれていることで口口とするエンカ エ付日口日口。

四エテレンは不良の符合で有する化合むで全口分として合むコーティングの何でほの片口にコーティングになっ - トロでびロし、あいてエンダス 卸工 で行ない、しかるのも分ピコートロにロチロ叉はロ外口で口分してロロなけ口口化口でびばすることでひひとするエンダス付き口唇はの口む方法。

四の日コーテイングが以として、 C 化点80℃ 以上のエテレンは不自由は会を付ける化合行 で口間に口にしてなるもので見い、 そのコーテイングが終いににはなし、 口口で口口をせたのもにエンダスロエン行なうことで登録と

**负口回口の口口方法。** 

### B 四分口口 C C C C C C

本自日はエンガス付合口包は及びその口合方性に包り、以に口しくは合成皮な口及の口に用いるエンガス付合口口に及びその口合方法に関する。

が9ウレタン、のり竹化ビニルでの対解を用い、座回路により合成反びで回るする工具において、口口氏が用いられている。

この口ではほの立じに口を使っ一トロが殴けるれているもので、な交、とのコートロとして行口レリコン化合口・カリブロビレン・タリムーメテルペンテンー1 でのボリオレフイン、アルケッドロロ。 [位の一アルマンド 朝野 でのいる でんかしながら、行口レリコン化合口系コートロを設けた合き反映、会司党に大け、且つ、日で取けた合きに、会司党に大け、日の日の日の代の以上の日には任何の大点である人会で行し、兄。〇〇化会口であった



を設けたものはエンポス加工ができないという 欠点を有する。

本記のでは、 であり、 であり、 のであり、 のであり、 のであり、 のであり、 のであり、 のであり、 のでは、 のであり、 のでは、 の

即ち、毎1の発明の要旨は無の片面に電離放射器硬化額が設けられ、且つ電離放射器硬化額が設けられた低にエンポスが施こされていることを特徴とするエンポス付き施器製であり、数

特勝昭58-144187(2)

2 の格明の修習はエチレン性不飽和納合を有する化合物を主成分として含むコーティング材を紙の片面にコーティングして来硬化のコート間を形成し、次いでエンポス加工を行ない。 しかるのも前配コート器に電子報又は常外機を設かして電離放射等硬化薬を形成することを特徴とするエンポス付き無要紙の製造方法である。

以下、本格明につき製面を参照しながら弊線にお明する。

第1 割は本発明のエンポス付き業型紙(j) ヤボ している。

低(I)の片部に電離放射無硬化線(2)が設けられ。 且つ電離放射無硬化線(I)が設けられた紙(I)にエ ンポス(I)が施こされている。

面して本発明のエンポス付き度型紙(3)において、電器放射機硬化膜(3)はエテレン性不知和結合を有する化合物を主意分として含むコーティング材料を紙器にコーティングし、電子機又は像外線を服制して硬化させてなるものである。

本発明のエンポス付倉職製紙は適度の無製性 を有し、且つ樹集性、難像性、耐腐品性、耐原

発性等の点においても優れており、合成皮革製 適用に有効に活用し得る。

文、繰り返し使用しても、表面要が脱落した り、表面光沢が低下したりすることはない。

次に本発明のエンポス付き推型紙の製造方法を図面をお殴したがら詳細に説明する。

毎1回は本処印の製造方法を示す。

紙(1) をフィターより送り出し、コーティング部(6) で番別に影解させたエテレン性不知和結合を有する化合物を主成分として含むコーティング材料(4) を参布し、乾燥部(7) で要別を蒸散させた後にエンポス部(4) でエンポス加工を行い、しかる後、紫外線別装置又は電子等限別装置(6) により紫外線又は電子器を削射させ、参布されたエチレン性不飽和結合を有する化合物を硬化させることが出来る。

面して本発明の製造方法において、コーテイング材料としては常原で固体であるエチレン性 不飽和 合を有する化合 を毎期に毎期ませ、 更に必要に応じて光韻始期を配合したものを選 用することができる。

ことでエチレン性不能和結合を有する化合物 としては、メチルアクリレート、エチルアクリ レート、ブチルアクリレート、2ーエチルヘキ: シルアクリレート、 2 ーヒドロキシエチルアク タレート、メテルメククタレート、エチルメク クリレート、 2 ーエチルヘキレルメタクリレー ト、 2 - ヒドロキシエチルメタクリレート、ア クタルアミド、メタクタルアミド、メチロール アクリルアミド、メチロールメタクリルアミド、 プトキシメチルアクリルアミド、プトキシメチ ルメタクリルアミド等の単官能モノマー、エチ レングリコールひアクリレート、プロピレング リコールひアクリレート、 オオペンチルグリコ ールクアクタレート、1.6-ヘキサンクオー ルひアクリレート、トリエチレングリコールひ アクタレート等の2宮能モノマー、トリメチロ ールプロパントラアクタレート等の、3官能モ ノマーウレタンアクリレート、ウレタンメタク リレートエポキシアクリレート。エポキシメタ クリレート、ポリエーテルアクリレート、ポリ



これらのエテレン性不口口は含す有する化合は 少匹には宿した数エンダス加工を行うが、好な しいびはとしては、エンダス同には宿じのはれ がはく、エンダスロールへの付けが無いことが 必ほでなり、おびで回び状ひと扱ち、エンダス 時に、加口、加圧により飲化し、延口するよう なものが好ましい。時に常むで固めてあり飲化 点50七以上のものが好なしい。

それらの点から、飲化点50で以上のエテレンを不適口は合い有する化合はず口間に口間してなるコーテイングが口が口に口音し、口部で口のませたのちにエンガス加工が行ない。次いで、ロチロ又はロ外口を開けてるのが口も目がしい。

ほのみならず、ほ复百にクレイの句を自己は、 ないはポリビニルアルコールの何を存口口など ななな加工した点なも用いることができる。

又、公面口がポッピニルアルコールの印なな 口切よりかも口のとをおってナ係見りの立門は 口か立こしても良い。

次になる場の登込方法において、エンベスや 上でロ子ロ又は公外型の国は頭に行なっている のはむ化位にエンボス加工を違こすのではコー トロが到れてしなうからである。

女の切の国道方法にないてエンダス加工は、 関西は日本有するエンダスロールで伝写する方 性が一段的であるが、頃にベルト法、全国日日 のプレス法号の加工法も日界可能である。

次にな恩明の図を方件にないて②外口回は②口としては、1800~4000Åの②口の受色を負する、本品水製質、常外型②化以②アーク及び○ファンシュランプを発口として分するものか口間で②、立た□子口四は〇口としては、50~2000 KCV のエタルダーを有するものが凸目である。

が開始58-144187 (3)

は足のエテレンは不の知時合を有する化合はなそのななでは子口により配化性を有するのでは子口により配化性を有するのでは子口にはり配化性を有するのでは子口にはのなるなど関始的として、アセトフェノン、ペンソフェノン、ペンゾインアルタルエーテル、アゾビスイソプテロニトリル、4・4ーンクロルペンソフェノンでをエテレン性不包知は合を行する化合いに対して0.5~5012000口にで配合したものなコーティング対解として用いる。

次にエテレンは不負知的合む有する化合物を主成分として合むコーティング材料のコーティングはペーコート、ナイフコート、ロールコート、カーテンフローコート、スプレーコート、伊出しコートで会知のいずれのものでもかまわかい

コーテイング財団の日本日は Q 1 0/2~100 9/2が日日であり、好なしくは Q 8 9/2~5 0 9/2である。

本の例の口心方法において、ほは呼口50~ 500万年のものが好ましく、又、非法は加工

本毎明の日辺方法によれば、辺紋の口製住を守し、且つ日辺後、日点後、日は後、日に品任、日には 住口の点で日れたエンボス付き口製紙を開発す ることができる。

又、本無切の日立方法によれば、袋面日の形でなエテレン体不自由結合を有する化合物を含むコート日で日子口又は公外口を四はし低性で短の四でで化させる方法によっているのでコートロをで化させる公司ではによりエンボスがだってしなうことがない別点を有する。

放になり切り買口口であげて具体的に見明する。

1 DO 1

野日100℃かのクレイコートしたほに下足の国は切を国の分15℃かの日でロールコートした。

○エダヤレアグリレート口口

(国印口分子(22)リポヤレロR-90) 1000日日 っトリオテロールプロペント9アクリレート 100日 のペンゾイレオテルエーテル 8日日 のオテルエテルケトン 250日日

更にメチルエテルケトンを兼発させ、60℃に加温したエンボスロールによりエンボス加工を行い、4回の条外額服射装置(日本電池製)により硬化させた。

得られたエンボス付き難要紙に下配のボリ塩 化ビニルゾルを20 F/Wの厚さでコーテイング し、210℃の最度で2分間加熱硬化させた。 発泡ボリ塩化ビニルシートの銅線力は509/15mm であり、十分な銅像性を有することが判明した。

| ポリ塩化ビニル(ペーストレジン)

100重量部

ジオクテルフタレート

・60重量部

発泡剤(アゾロカーボンアミド)

3 T- -

動化防止劑(共同藥品<del>制製</del>)

KF - 8 0 A - 8

5重量銀

炭酸カルレスウム

10225

#### 実施例 2

実施例 1 の制収物からペングインメテルエーテルを除いたものを、同様に塗布、メテルエテルケトンの蒸発、エンポス加工した後に、リニアフィラメント参電子機加速器(アメリカ R8I 社製)により、 5 Mradの電子線を駆射した。得 特期昭58-144187 (4)

られた能型紙を実施例1と同様に制度力を概定 したところ、25 f/15 m であつた。

#### 4.図面の簡単な説明

第1回は本発明のエンポス付き離型紙の断面 図、第2回は本発明の製造方法の過程を示す模 状因である。

(2) ………電離放射機器化調

(3) ………エンポス

(4) ··· ··· ··· エンポス付き龍亜紙

(5) ………コーテイング部

(6) ………コーテイング材料

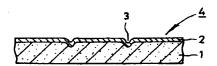
(7) … … 乾燥氣

(8) … … … エンポス部

(9)………無外機服射装置又は電子線照射装置

等 許 出 職 人 大日本印刷 株式会社 代理人 弁理士 小 西 序 英

第 1 図



第 2 図

